



聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2020 年第三季自結財務報告

2020 年 10 月 28 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(28)日公告 2020 年第三季自結財務報告。

2020 年第三季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 65.66 億元，較前季增加 9%，較去年同期增加 3%
- ◆ 本季合併毛利率為 43.4%，較前季減少 1.4 個百分點；本季營業淨利率 32.7%，較前季減少 0.9 個百分點
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 21.46 億元，較前季增加 6%，較去年同期增加 7%
- ◆ 本季稅後淨利為新台幣 19.67 億元，為歷史單季新高，較前季增加 19%，較去年同期增加 20%；每股盈餘為新台幣 4.68 元，同創單季歷史新高，前一季為新台幣 3.94 元

2020 年第四季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 預計第四季營收將較前一季成長 low-single digit 百分比。
- ◆ 第四季因產品組合變化，毛利率預計降至約 high-thirties 的水準。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

管理者評論

“2020年第三季在全球依舊嚴峻的新冠肺炎疫情及不斷升高的中美貿易衝突中落幕，雖然市場仍充滿不確定性，但穩懋的營收及獲利仍有不錯的表現，第三季營收較前一季成長9%，優於原先的預期，累計前三季營收達新台幣187億元，較去年同期年增率達29%。雖然產能利用率隨著新產能逐月開出而下滑，在產品組合優化下，單季毛利率達43.4%，與原先預期相去不遠。第三季稅後淨利及淨利率都同時登上穩懋單季歷史高點，分別為新台幣19.67億元及30%，除了新台幣4.68元的EPS創下歷年單季之最，累積前三季EPS新台幣12.38元也已超越去年全年的水準。

穩懋始終秉持著客戶分散、維持研發能量及持續擴充產能的長期策略，今年5,000片的產能擴充計畫已於第三季底完成上線，目前單月產能已達41,000片，是全球產能最大的砷化鎵晶圓製造公司。著眼於未來幾年5G網絡逐漸成熟，5G手機滲透率逐年上升將進一步帶動5G PA的需求提升，同時隨著全球頂尖智慧型手機業者繼臉部辨識之後進一步導入3D感測技術於AR應用上，預期將可帶動另一波風潮，也讓穩懋對於未來化合物半導體代工需求持續抱持樂觀期待。為滿足客戶的長期需求，穩懋甫於8月中獲得行政院科技部核准，即將進駐南部科學園區高雄園區投資設廠，可望為成立剛滿20年的穩懋奠定下一個20年的基礎。

展望第四季，我們預計營收將較上一季成長 low-single digit 百分比；因產品組合變化，毛利率預計降至約 high-thirties 的水準。”

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於 1999 年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路 (GaAs MMIC) 的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司 (RFIC Design Houses) 外，並致力吸引與全球整合元件製造 (IDM) 大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體 (HBT) 和應變式異質接面高遷移率電晶體 (pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及 3D 感測領域中，穩懋更以 MMIC 生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。